歪 SiGe を用いた MOS 型光変調器の変調帯域改善に関する検討 Modulation bandwidth improvement of MOS optical modulators based on strained SiGe 東大院工¹, JST-CREST², 日本学術振興会特別研究員³

 $^{\circ}$ 韓 在勲^{1,2,3}, 竹中 充^{1,2}, 高木 信一^{1,2}

Univ. of Tokyo¹, JST-CREST², JSPS research fellow ³

^OJaehoon Han ^{1, 2, 3}, M. Takenaka ^{1, 2}, S. Takagi ^{1, 2}

E-mail: hanjh@mosfet.t.u-tokyo.ac.jp

【はじめに】近年,LSIの更なる高性能化・低消 費電力化に向けてシリコンフォトニクスが活発 に研究されている.しかし,間接遷移型半導体で ある Si では変調効率が低く,高性能な光変調器 の実現が急務とされている[1]. 様々な構造の Si 光変調器が報告される中, MOS 型光変調器は, 大きい蓄積容量が実現できることから,他の構造 より高い変調効率が報告されている[2].また、ゲ ート絶縁膜の膜厚スケーリング(EOT スケーリ ング)による蓄積容量の増大により,更なる性能 向上が見込まれる[3]. しかし, MOS 型光変調器 は、その大きい蓄積容量に起因する変調帯域の劣 化が懸念され,これは絶縁膜厚スケーリングによ り一層顕著になる[4]. この問題を解決するため, 我々は歪 SiGe においてホールの有効質量が軽く なることに注目し[5], 歪 SiGe スラブを用いた寄 生抵抗の低減による MOS 型光変調器の変調帯域 幅の改善に関して調べた.この効果により, Si_{0.8}Ge_{0.2}を用いた場合, MOS 型変調器の帯域幅 が1.3倍改善することが分かったので,報告する. 【解析結果】変調帯域について解析を行った MOS 型光変調器の構造[2]およびその等価回路を 図1に示す.各パラメータを用いて、図1の等価 回路に基づくデバイスの総抵抗と総容量を求め, RC時定数と変調帯域を計算した.[2]で報告され た構造で位相シフタ長を 200 µm とした場合 p 型 スラブの抵抗が 4.15 Ω と, n 型メサとポリ Si の 抵抗が 3.81 Ωとなり,総抵抗は 7.96 Ωとなる. 5 nm 膜厚の SiO₂の MOS 容量は 8.23 pF となるた め,ドライバーのインピーダンスをデバイスの抵 抗と同じと仮定すると変調帯域は24.1 Gbpsとな り報告値(25 Gbps)とほぼ一致する.ここで, MOS 型光変調器の p 型スラブを歪 SiGe にする と,正孔の有効質量の軽量化による抵抗の低減が 期待されるため、変調帯域の改善が見込まれる. まず, 歪 SiGe の抵抗の Ge 組成依存性を調べる ため、報告されている歪 SiGe のドリフト移動度 [6]を用いて抵抗率を求めた結果を図 2 に示す. 不純物濃度は 10¹⁸ cm⁻³ とした. 図 2 から分かる ように、抵抗率は Si と比較して Si_{0.8}Ge_{0.2} で 0.54 倍, Si_{0.7}Ge_{0.3}で 0.43 倍となる. この検討では, Si スラブを全て歪 SiGe に置き換えることを考えて いるので, 歪 SiGe の臨界膜厚[7]などを考慮して Si0.7Ge0.2を用いて議論を進める.上記の議論で求 めた抵抗率を用いて Si と Si_{0.8}Ge_{0.2}の帯域幅を

比較した結果を図 3 に示す.素子構造に依らず EOT スケーリングによる変調帯域の低下が見ら れるものの,歪 SiGe スラブを用いることで,Si スラブに比べ1.3 倍の変調帯域改善が確認された. 歪 SiGe 中におけるプラズマ分散効果のも報告さ れているので[3],これらの効果を組み合わせる ことで,高速かつ高性能な MOS 型光変調器の実 現が期待される.

【謝辞】本研究の一部はNEDO「フォトニクス・エレクトロニクス融合システム基盤技術開発(PECST)」の助成により実施した.また,PETRAの藤方氏と高橋氏の助言にも感謝する.

【参考文献】[1] G. T. Reed, *et al.*, Nature Photonics **4**, 518 (2010). [2] J. Fujikata, *et al.*, OFC2010, OMI3 (2010). [3] M. Takenaka and S. Takagi, IEEE J. Quantum Electron. **48**, 8 (2012). [4] A. Abraham, *et al.*, GFP 2014, WB2 (2014). [5] M. V. Fischetti and S. E. Laux, J. Appl. Phys. **80**, 2234 (1996). [6] T. Manku, *et al.*, IEEE Trans. Electron Device **40**, 1990 (1993). [7] R. People and J. C. Bean, Appl. Phys. Lett. **47**, 322 (1985).







図2. 歪SiGeの抵抗率のGe組成依存性.



図3. SiとSi0.7Ge0.2スラブを用いた場合の変調帯域比較.